

平成 29 年 1 月 13 日

各位

三菱製紙株式会社

「ネプコン ジャパン 2017 電子部品・材料 EXPO」 出展のご案内

三菱製紙株式会社は、平成 29 年 1 月 18 日（水）～1 月 20 日（金）、東京ビッグサイトにて開催される「ネプコン ジャパン 2017 電子部品・材料 EXPO」に出展いたします。

本展示会では、電子材料市場向けに開発した各種機能性ドライフィルムレジスト、新規レジストプロセス関連製品の出展を予定しておりますので、是非当社ブースにお立ち寄りください。

今後もお客様のご要望に応じた機能性フィルム製品の試作・開発に取り組んでまいります。

記

【開催概要】

名称 : ネプコン ジャパン 2017 電子部品・材料 EXPO  
会期 : 平成 29 年 1 月 18 日（水）～1 月 20 日（金）  
時間 : 10:00～18:00（1/20 のみ 17:00 まで）  
会場 : 東京ビッグサイト 西ホール  
URL : <http://www.nepconjapan.jp/>

※ 日本最大のエレクトロニクス製造・実装技術展です。  
無料招待券を上記 URL よりダウンロードできます。

【当社出展概要】

出展場所 : 西 2 ホール 小間番号「W13-11」  
出展内容 : 溶解剥離性ドライフィルムレジスト (MS 9000 series)  
高耐久性サンドブラスト用ドライフィルムレジスト (MS 7000, MS 8000 series)  
高耐薬品性ドライフィルムレジスト (KN 30 series)  
厚膜溶解剥離性ドライフィルムレジスト (MSP 4000 series)  
ポジ型レジスト付きフレキシブル基板材料 (PS FCCL)  
新ソルダーレジスト層形成技術 (SR ReFiP)  
銀ナノ粒子インク (Nano Benefit 3G)  
シルバープレーティングシステム (Silver Plating System)

【本件に関するお問い合わせ先】

イメージング事業部 印刷感材営業部 (担当 : 鹿野)

E-mail: [denzai@mpm.co.jp](mailto:denzai@mpm.co.jp)

TEL: 03-5600-1475 FAX: 03-5600-1413

以上